

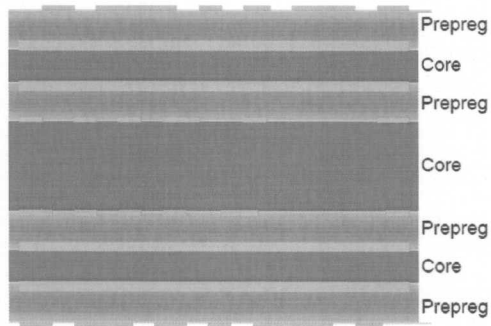
ชื่อ..... รหัส.....

1. จงอธิบายความหมายต่อไปนี้ (20 คะแนน)

1.1 Photoresist (2 คะแนน)

1.2 Ion Implantation (2 คะแนน)

1.3 Core และ Prepreg บน PCB Stackup ดังแสดงในรูปคือ (3 คะแนน)



ชื่อ..... รหัส.....

1.4 PCB ชนิด 1 OZ มีความหมายว่าอย่างไร (3 คะแนน)

1.5 Blind Via แตกต่างจาก Buried Via อย่างไร (4 คะแนน)

2. ให้นักศึกษาอธิบายรายละเอียดการผลิตไอซีซีพตามขั้นตอนต่อไปนี้ (16 คะแนน)
2.1 Czochralski Process (4 คะแนน)

ชื่อ..... รหัส.....

2.2 การผลิต แผ่น เวเฟอร์ (Wafer) (2 คะแนน)

2.3 การสร้างลายวงจรบนแผ่นเวเฟอร์และการแยก Die (4 คะแนน)

2.4 IC Packaging (2 คะแนน)

ชื่อ..... รหัส.....

2.5 การเชื่อมต่อแบบ Wire bonding และ Flip-Chip (4 คะแนน)

3. ให้นักศึกษายกตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานนาโนเทคโนโลยีพร้อมคำอธิบายตามหัวข้อต่อไปนี้ (20 คะแนน)

3.1 นาโนอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

(5 คะแนน)

3.2 วัสดุนาโน

(5 คะแนน)
